

2020 Moldex3D 高校 CAE 人才培育技能竞赛

作品授权及刊登同意书

请于 2020 年 7 月 10 日(五)前，亲签后扫描 E-Mail 至 tracygu@moldex3d.com

本人(及本人团队)_____ (以下简称本人)因参加科盛科技股份有限公司(以下简称科盛科技)主办之「2020 Moldex3D 高校 CAE 人才培育技能竞赛」(以下简称本活动)，同意以下本活动参赛办法及规定，并授予科盛科技许可使用以下权利：

1. 本人拥有完全权利与权限签署并履行本同意书，且已取得签署本同意书必要之第三者同意与授权许可使用。
2. 本人兹同意将所有缴交本活动的参赛作品(含文字、CAD模型、图片及影片)等内容，永久无偿授权许可科盛科技及其国内外关系企业及其授权许可之第三方，不限载体、用途、使用次数、地区、期间，包含但不限于散布、复制、发行、出租、修改、改编、翻译、再授权、广播、信息网络传播权、公开展览、表演、放映、摄制、汇编与公开发表之权，提供大众进行检索、浏览、下载、传输、列印及公开使用等。
3. 本同意书为专属授权(即“专有使用权”)。本人保证并无侵害任何第三人之著作权、专利权、商标权、商业秘密或其他知识产权，且未曾参加其他CAE模流分析公司所举办的同性质竞赛。作品如涉及著作权之侵权或其他不法行为，概由本人自行负责，科盛科技得取消得奖资格并追回奖金、奖状及奖品。
4. 本人作品若有侵害他人权利或涉及违法，本人愿负全部之赔偿责任。若因此致科盛科技受有损害，本人愿负赔偿责任。

此致

主办单位：科盛科技股份有限公司

立同意书人(团队代表)

(签名)

身分證号

年

月

日

主管/指导教授及单位签章

(签名)

身分證号

年

月

日

公司(大章)	
法定代表人(小章)	
职称	
统一社会信用代码	
地址	
日期	